

C2625ASG

General Description (概述)

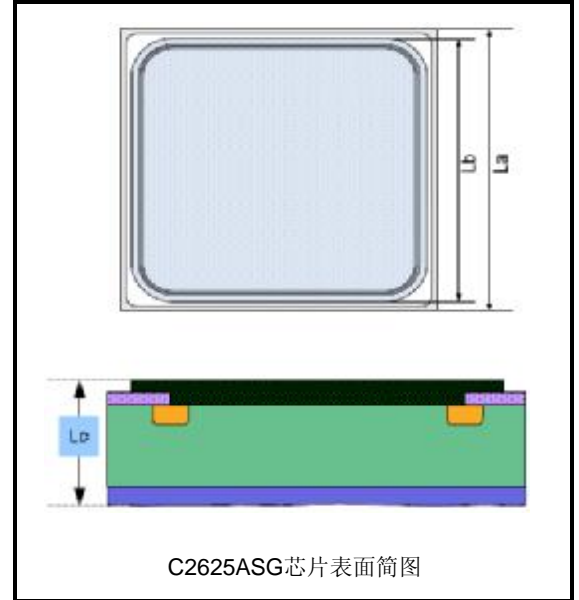
C2625ASG using silicon extension process manufacturing; Low Vf and high efficiency.

C2625ASG是采用硅外延工艺制造的肖特基二极管芯片；低正向压降且高效率。

All of these Schottky Diodes are designed for applications such as Rectifier, Reverse polarity protection circuit.

该产品广泛用于整流、极性保护电路等。

Items (项目)	Description (描述)
Wafer Size 硅片尺寸	5 Inch
General Parameters 主要参数	25V 1A
Chip Size 管芯尺寸(La)	670 μm
Pad Size 压点尺寸(Lb)	580 μm (Typical)
Chip Thickness 芯片厚度(Lc)	280 ± 20 μm
Surface Metal 正面金属	Ag
Backside Metal 背面金属	Ag
Cutting Street 划片道尺寸	40 μm



Absolute Maximum ratings (极限参数, Ta=25°C)

Parameter 参数	Symbol 符号	Value 额定值	Units 单位
DC Blocking Voltage 最大直流阻断电压	V_{RRM}	25	V
Average Rectified Forward Current 正向平均整流电流	I_{FAV}	1	A
Nonrepetitive Peak Surge Current@8.3mS 正向峰值浪涌电流	I_{FSM}	40	A
Operating Junction Temperature 最高工作结温	T_J	125	°C
Storage Temperature 存储温度	T_{STG}	-40~125	°C

Electrical specification (电参数规格, Ta=25°C)

Parameter 参数	Symbol 符号	Test Conditions 测试条件	Min 最小值	Max 最大值	Typ 典型值	Units 单位
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压	V_{BR}	$I_R=100\mu A$	25	-	-	V
Forward Voltage 正向压降	V_F	$I_F=1A$	-	0.45	0.425	V
Reverse Leakage Current 反向漏电流	I_R	$V_R=25V$	-	50	-	μA

声明:

- 1、扬州国宇保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 2、划片损失及崩边不能超出划片道给定尺寸范围。
- 3、当测试温度变化参数亦会有所调整。